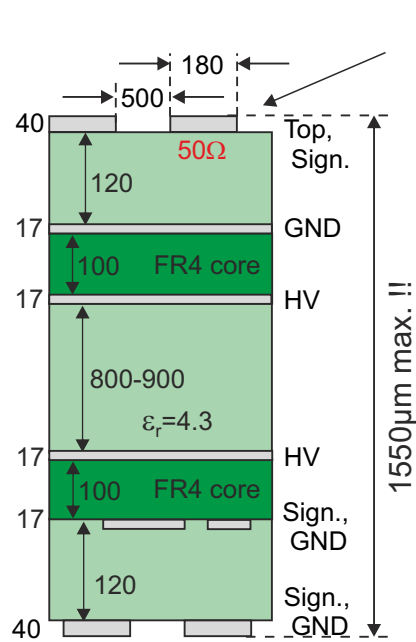


TCT Board Lagenaufbau



Kein Lötstopplack über 50Ω Leitungen,
bondbare Oberfläche,
auf dem Kupfer: 5µm Nickel, 0.1µm Gold
(Alu-drahtbonden).